

California Micro Devices arbeitet mit SPEL Semiconductor zusammen, um zwei Leadless Molded Package-Linien einzurichten - gemeinsame Investition wird auf USD 7,75 Mio. Geschätzt

Neue Fertigungslinien sollen im Laufe der nächsten zwei Quartale qualifiziert und betriebsbereit sein

MILPITAS, Kalif., 24. Jan./PRNewswire/ --

California Micro Devices (Nasdaq: CAMD) meldete heute den Abschluss einer Vereinbarung mit SPEL Semiconductor für die Erweiterung der Kapazität der Leadless Molded Package-Linien (LMP) von SPEL und die Erweiterung zur Unterstützung zweier weiterer neuer Pakete mit kleinem Profil. California Micro Devices wird ca. USD 2,2 Mio. des insgesamt auf USD 7,75 Mio. geschätzten Investitionsumfangs, der für die Kapazitätserweiterung zur Unterstützung der zusätzlichen Fertigungslinien benötigt wird, beisteuern.

Mit der zunehmenden Beliebtheit mobiler Endgeräte mit dünnem Profil und anderen kleinen tragbaren Geräten, wie z.B. tragbare Medienplayer, MP3-Player und digitale Kameras und Camcorder, hat sich die Nachfrage nach den mobilen Schutzprodukten des Unternehmens in leitungslosen Paketen mit kleinem Profil dramatisch gesteigert. Die Vereinbarung mit SPEL bietet California Micro Devices eine bedeutende, kostengünstige Erweiterung seiner Montagekapazitäten, um seine Durchdringung dieses wachsenden Segments des mobilen Schutzmarkts fortzusetzen. Die beiden neuen Linien werden Montagekapazitäten für die Produkte des Unternehmens bieten, die TLMP- und uTLMP-Pakete verwenden.

„Die Technologie und Fertigungskompetenzen von SPEL ergänzen unsere Strategie, unsere Schutzprodukte für mobile Endgeräte mit dem geringsten Platzbedarf und den kleinsten Profilen zu verpacken“, sagte Robert V. Dickinson, Präsident und CEO von CMD. „Wir freuen uns darauf, unsere Beziehung mit SPEL im Rahmen der Zusammenarbeit bei der Inbetriebnahme der neuen LMP-Linien dieses Jahr auszuweiten.“

Informationen zu SPEL Semiconductor Limited

SPEL Semiconductor Limited ist das führende indische Lieferantenwerk für komplette Wafer-Sortierung und IC-Montage und -Tests aus einer Hand. SPEL wurde 1988 gegründet, hat seinen Firmensitz in Chenani, und bediente den lokalen Markt von 1988 bis 1994. Nachdem SPEL seine Fähigkeiten im Heimatland unter Beweis gestellt hatte, konzentrierte es sich ab 1995 zunehmend auf den anspruchsvolleren globalen Markt. Seitdem bedient das Unternehmen seit nunmehr 10 Jahren Silicon Valley und andere Teile der Welt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.spel.com.

Informationen zur California Micro Devices Corporation

California Micro Devices Corporation ist ein führender Hersteller anwendungsspezifischer Analog- und Mischsignal-Halbleiterprodukte für mobile Enderäte, digitale Verbraucherelektronik und Personalcomputer. Zu den wesentlichen Produkten des Unternehmens zählen Geräte für mobile Endgeräte, digitale Verbraucherelektronikprodukte, wie z.B. digitale Fernseher und Personalcomputer, sowie Analog- und Mischsignal-ICs für die Displays mobiler Endgeräte. Detaillierte Informationen über das Unternehmen und seine Produkte finden Sie unter www.cmd.com.

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsorientierte Aussagen die gemäss den Safe Harbor Provisions des Private Securities Litigation Reform Act of 1995 gemacht werden. Sie sind keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Ereignisse. Sie basieren auf aktuellen Erwartungen, Annahmen, Glauben, Vermutungen und Zielen und Aufgabenstellungen und sind mit Unsicherheiten behaftet die nur sehr schwer vorher zu sehen sind. Daraus ergibt sich, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse sich nachhaltig von den gemachten Aussagen unterscheiden können. Oft können solche Aussagen durch die Benutzung der Wörter wie beabsichtigt, erwartet, plant, glaubt, vermutet und schätzt identifiziert werden. Zu den zukunftsorientierten Aussagen in dieser Pressemeldung zählen Aussagen dazu, dass die Kosten der SPEL-Kapazitätserweiterung ca. USD 7,75 Mio. betragen werden; dass das Unternehmen die Durchdringung seiner mobilen Schutzgeräte in den Märkten für mobile Endgeräte mit dünnem Profil und andere kleine tragbare Geräte steigern wird; dass SPEL seine beiden Fertigungslinien im nächsten Halbjahr erfolgreich fertig stellen, zertifizieren und in Betrieb nehmen wird; dass SPEL ein kostengünstiger Produzent von TLMP- und uTLMP-Paketen sein wird, sowie die Strategie des Unternehmens, seine Schutzprodukte für mobile Endgeräte mit den kleinsten Platzanforderungen und den geringsten Profilen zu verpacken. Diese zukunftsorientierten Aussagen basieren auf unseren Annahmen über und Einschätzungen der Zukunft, die sich als wahr herausstellen können oder nicht, und unterliegen eine Vielzahl von Risiken und Unwägbarkeiten, zu denen u.a. gehört, ob die LMP-Montagelinien von SPEL teurere Geräte benötigen wird als bisher geschätzt oder während der Bauphase weitere Budgetüberschreitungen ausgesetzt sein wird; ob die geplante Leistung unserer mobilen Schutzgeräte die Anforderungen unserer Kunden erfüllt, so dass diese unsere Geräte weiterhin für das Design ihrer Produkte verwenden; ob unsere Geräte ihre Konstruktionspezifikationen erfüllen; ob Wettbewerber Geräte zu niedrigeren Preisen einführen, was zu Marktanteilsverlusten für uns führt; ob SPEL Schwierigkeiten mit Tarifpartnern, Regierungsbehörden oder Finanzen bekommen, die dazu führen, dass die Fertigstellung seiner Montagelinien verzögert oder verhindert wird; ob SPEL unerwarteten Kosten oder Ausgaben oder technischen Schwierigkeiten ausgesetzt ist, so dass sich das Unternehmen nicht als Produzent kostengünstiger Pakete erweist; und ob Konstruktionsprobleme auftreten oder ob SPEL technische Probleme bei der Verpackung unserer Produkte mit kleinem Platzbedarf und den geringsten Profilen hat, sowie die Risikofaktoren, die auf den bei der Securities and Exchange Commission auf den Formularen 8K, 10K und 10Q eingereichten Unterlagen detailliert dargestellt sind. Aufgrund dieser und anderer Risiken können sich die zukünftigen tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens nachhaltig und deutlich von den oben diskutierten unterscheiden. Diese zukunftsorientierten Aussagen betreffen nur die Zeit bis zum Veröffentlichungsdatum dieser Mitteilung; wir sehen keine Verpflichtung diese Aussagen durch Veröffentlichungen zu aktualisieren oder Überarbeitungen dieser Aussagen heraus zu geben, gleichgültig ob auf Grund von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder anderweitigen Vorfällen, soweit keine gesetzliche Verpflichtung etwas Anderes verlangt.

/CONTACT: Kevin Berry, Chief Financial Officer of California Micro
Devices, +1-408-934-3144, or Kevin@cmd.com/

/Web site: <http://www.calmicro.com>

<http://www.spel.com/> (CAMD)

(CAMD)